

量子ドットと樹脂の混合体樹脂インク

熱硬化後、シリコン系 LED 封止材を上塗りしても安定

ペロブスカイト型量子ドットやInP/ZnS量子ドットと樹脂の混合体インクを作りました。約100℃で熱硬化後、シリコン系LED封止材料を上塗りして再び約100℃で熱硬化させた後も蛍光が安定です。

